

LAMINA DE RESPUESTO PARA PLACA DE ALTA TEMPERATURA COMPATIBLE CON P1P, P1S, X1C Y X1E

FAP002-1



Descripción:

Lamina de repuesto para placa de alta temperatura compatible con impresoras 3D Bambu Lab P1P, P1S, X1C y X1E.



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	22/01/2025

